2024-2030年中国芯片设计行业市场发展监测及投资前景展望报告

报告大纲

华经情报网
www.huaon.com

一、报告简介

华经情报网发布的《2024-2030年中国芯片设计行业市场发展监测及投资前景展望报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.huaon.com//channel/jingpin/tmt/936086.html

报告价格：电子版: 9000元　纸介版：9000元　电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

《2024-2030年中国芯片设计行业市场发展监测及投资前景展望报告》由华经产业研究院研究团队精心研究编制，对芯片设计行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合芯片设计行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判；为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 芯片设计概况
第一节 芯片设计沿革
一、芯片设计定义
二、发展历程
三、技术沿革
四、投资特性
五、企业成长
第二节 芯片设计当前发展综述
一、芯片设计产销量分析
二、当前技术、设备、生产工艺分析
三、行业企业发展情况
四、芯片设计所处经济周期
五、行业景气性分析
六、行业主要经济指标分析
第三节 国内外代表性国家芯片设计发展对比
一、发展模式
二、技术特点
三、芯片设计结构
四、企业发展
五、发展走向
第四节 国内外芯片设计发展存在的问题

第五节 国内外芯片设计发展的SWOT分析

第二章 芯片设计发展环境分析
第一节 芯片设计政策环境
一、芯片设计规划
二、税收政策
三、投融资政策
四、行业准入政策
第二节 芯片设计链环境
一、上游行业发展分析
二、下游市场发展分析
第三节 国际贸易环境
一、国内进出口政策分析
二、国外进出口政策分析
第四节 技术发展环境
一、国内企业技术研发环境分析
二、国内企业技术引进环境分析
三、外资企业技术发展分析
四、国内外技术标准分析
第五节 宏观经济环境.
第六节 重点国家和地区芯片设计环境分析

第三章 芯片生产分析
第一节 行业芯片产量、产值分析
第二节 芯片生产成本与出厂价格分析
第三节 芯片当前产能配置分析
第四节 生产模式分析
第五节 芯片产销率与库存投资
第六节 芯片产出结构
第七节 芯片产出企业、地域集中度分析
第八节 不同地区生产情况分析
第九节 芯片生产技术发展
第十节 产量预测

第四章 芯片行业供给分析

第一节 芯片供给量分析
第二节 芯片供给方式分析
第三节 芯片供给错位情况分析
第四节 芯片供给过剩情况分析
第五节 芯片产量与实际供给量关系分析
第六节 主要芯片供给企业分析
第七节 主要芯片供给地区分析
第八节 近期芯片供给规律分析
第九节 不同芯片供给模式对比
第十节 芯片供给量预测

第五章 芯片行业需求分析
第一节 芯片需求量分析
第二节 芯片需求特点分析
第三节 芯片需求错位情况分析
第四节 芯片潜在需求开发分析
第五节 芯片消费量与实际需求量关系分析
第六节 主要芯片需求领域实际需求分析
第七节 主要芯片需求地区实际需求分析
第八节 近期芯片需求发展规律分析
第九节 不同芯片需求空间对比
第十节 芯片需求量预测

第六章 芯片设计细分市场分析
第一节 电子芯片市场
一、电源管理芯片市场
（一）全球市场概况
（二）我国市场规模
（三）我国市场结构与特点
（四）市场发展预测
（五）主要竞争厂商
二、LED外延芯片市场
（一）主要竞争厂商
（二）芯片技术规划及发展趋势
（三）芯片性能与价格

（四）市场规模预测
第二节 通讯芯片市场
一、全球市场概况
二、主要竞争厂商
第三节 汽车芯片市场
一、全球市场概况
二、我国市场规模
三、主要竞争厂商
第四节 手机芯片市场
一、全球市场规模
二、我国市场规模
三、我国市场结构与特点
四、市场发展预测
五、主要竞争厂商
第五节 电视芯片市场
一、DLP（数码光处理）芯片
（一）技术
（二）掌握核心芯片技术的厂商
（三）应用该技术的彩电厂商
二、LCOS芯片
（一）LCOS微显示器
（二）LCOS面板技术
（三）主要优点
（四）掌握核心芯片技术厂商
（五）应用该技术的彩电厂商
三、数据机顶盒芯片
（一）主要竞争厂商
（二）国内机顶盒生产商及其芯片解决方案
（三）芯片技术规划及发展趋势
（四）芯片性能与价格
（五）市场规模预测

第七章 行业重点企业分析
第一节 上海华虹（集团）有限公司
一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第二节 北京中星微电子有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第三节 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第四节 大唐微电子技术有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第五节 其他优势企业
一、杭州士兰微电子股份有限公司
二、有研硅谷
三、上海蓝光
四、扬州华夏
五、深圳方大
六、大连路美
七、中国台湾信越
八、中国台湾威盛电子
第六节 国外优势企业分析
一、意法半导体
二、飞利浦
三、德州仪器
四、英特尔
五、AMD
六、LG电子
七、国家半导体
八、FREESCALE

第八章 2024-2030年行业发展前景展望与预测
第一节 发展环境展望

一、宏观经济形势展望
二、政策走势及其影响
三、国际行业走势展望
第二节 相关行业发展展望
一、IC制造业展望
二、IC封装测试业展望
三、IC材料和设备行业展望
第三节 行业发展趋势展望
一、技术发展趋势展望
（一）芯片设计由ASIC向SOC转变
（二）设计方法由反向向正向转变
二、芯片发展趋势展望
三、行业竞争格局展望
第四节 芯片设计市场发展预测
一、2024-2030年中国芯片设计市场规模预测
二、细分市场规模预测
三、芯片结构预测
四、销售模式：由提供芯片向提供整体解决方案转变

第九章 芯片设计行业投资风险分析
第一节 宏观经济发展与芯片设计行业的相关性分析
第二节 政策风险评价
一、产业政策风险
二、信贷政策风险
三、金融政策风险
第三节 行业竞争风险
第四节 人力资源风险
第五节 行业风险综合评价

详细请访问：https://www.huaon.com//channel/jingpin/tmt/936086.html